



超導電性コンパウンド+薄膜成形性



うすくしても、超導電。

こんなお客様に

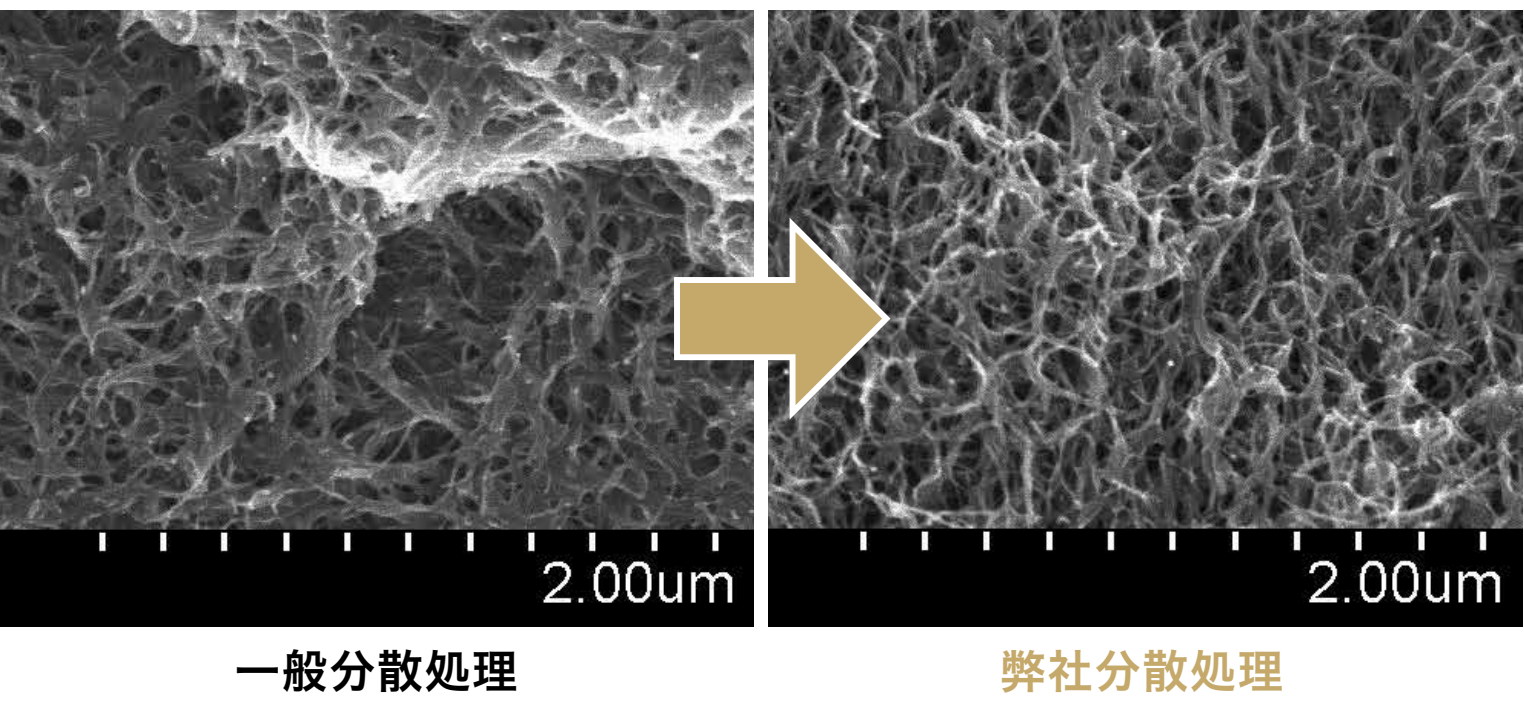
- ✓ 導電性樹脂の機械物性低下にお困り
- ✓ 高導電性樹脂の流動性・成形不良にお困り
- ✓ カーボンブラック脱落/発塵性にお困り 等

想定用途

- ▼ 半導体関連用途
搬送容器(射出成形品・フィルム) 等
- ▼ モビリティ用途
タッチセンサー部品 等
- ▼ その他用途
金属代替用途 等

大日精化の開発事例

01 | 高分散性@ナノ材料



一般分散処理

弊社分散処理

02 | 薄膜成形性



薄膜成形性/インフレーション成形 PP樹脂フィルム成形品 / 50μmT

03 | 機械物性・流動性維持

	ナチュラル	一般処方	弊社処方
導電性	—	1×10^{-1}	1×10^{-1}
衝撃強度	◎	×	○
引張伸び	◎	×	○
流動性	◎	×	○

➡ 高靱性かつ高延性の実現

04 | 高導電性

開発事例 | インフレーション成形フィルム (PP樹脂)

		100μmT	50μmT
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$	$3\text{E}+01$	$2\text{E}+02$
MFR	g/10min	2.5	2.5

開発事例 | T-dai成形フィルム (PC樹脂)

		100μmT	30μmT
体積抵抗率	$\Omega \cdot \text{cm}$	$5\text{E}+00$	$8\text{E}+01$
MFR	g/10min	3.0	3.0

本資料における各種物性データは、特定条件下における弊社評価結果ですので保証値ではありません。成形方法や成形条件、お取り扱い樹脂の特性により、測定結果が変わる可能性があります。

大日精化工業株式会社 / Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.

合樹・着材第2事業部 開発課 TEL:03-3662-4168 E-mail:resin2@daicolor.co.jp